

高电压/电流卡盘

用于晶圆测试和实验分析

- 电压可高达一万伏/电流达600A，可应用于MOSFET和IGBT等
- RDson数据保持精确和一致
- 薄晶圆安全装载
- 超低漏电流，最低可到5 pA
- 可用于搭配不同厂牌的探针台，适用性广，且可依不同应用只换卡盘顶盘，节省量产成本支出



产品介绍

- ✓ 可供选择的卡盘从简单的1.5千伏同轴连接到10千伏同轴连接，甚至3千伏三轴连接，且最大电流可达600安培，同时可以满足从 -65°C 到 +300°C 不等的测试温度需求。
- ✓ 该卡盘可以保证在高达一万伏的高压下超低漏电、避免击穿。
- ✓ 提供独特的探针台载物台定制化服务，让处理薄晶圆、Taiko晶圆等特殊形态晶圆变成可能。
- ✓ 客户不仅可以根据自己的需要选择卡盘的类型，还可以选择「仅更换卡盘顶盘」的服务，以应对测试需求不断升级的半导体市场。

产品种类

同轴连接

电压最大可至10千伏
在3千伏电压时漏电低至1,2 nA

三轴连接

电压最大可至3千伏
在3千伏电压时漏电低至50 pA

超低噪音

电压最大可至3千伏
在3千伏电压时漏电低至5 pA

